证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026077

合肥城建发展股份有限公司关于控股子公司减少注册资本进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案（一）》，同意公司控股子公司南京徽琥房地产开发有限公司（以下简称“南京徽琥”，公司持有50%股权，南京市棠悦房地产开发有限公司持有50%股权）减少注册资本，注册资本由5,000万元人民币减少至1,000万元人民币，各股东同比例减资。具体内容详见公司2026年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告（一）》（公告编号：2026004）。

二、本次减资进展情况

近日，南京徽琥取得南京市秦淮区政务服务管理办公室换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次减资完成后，南京徽琥注册资本变更为1,000万元人民币，公司认缴出资500万元人民币，持有其50%股权。

三、备查文件

1、南京徽琥营业执照。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026078

合肥城建发展股份有限公司关于控股股东减持计划的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

持有合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股份296,557,056股（占公司总股本比例36.92%）的控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”），计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2026年10月12日至2027年1月11日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过8,032,900股（占公司总股本比例不超过1%）。

一、股东的基本情况

序号	股东名称	股东身份	持股数量（股）	占公司总股本比例
1	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	控股股东	296,557,056	36.92%

二、本次减持计划的主要内容

1、股东名称、减持原因、减持数量和比例

股东名称	减持原因	减持数量（股）	不超过公司总股本比例
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	股东资金需求	8,032,900	1%

注：若减持期间公司有增发、资本公积金转增股本、送股、配股等股份变动事项，则拟减持股份数将做相应调整。

2、减持方式：集中竞价；

3、减持期间：2026年10月12日至2027年1月11日；

4、减持价格：按减持当日市场价格确定，遵循相关交易规则。

三、相关承诺及履行情况

1、本次减持系兴泰集团基于自身资金安排需要，不存在对上市公司经营前景、财务状况及未来发展规划的重大不利判断；

2、兴泰集团将严格遵守监管规定及交易规则，遵守减持比例、时间窗口等限制性规定，承诺在下列期间不买卖上市公司股票：

(1)上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内；

(2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

(4)证券交易所规定的其他期间。

3、兴泰集团前期出具的关于股份锁定、减持安排的相关承诺

(1)2016年3月，合肥城建原第一大股东合肥市国有资产控股有限公司将其持有的合肥城建185,316,118股国有股份无偿划转给兴泰集团事项办理完毕股权过户登记手续，本次无偿划转中，兴泰集团出具股份锁定承诺如下：

“兴泰控股本次受让的合肥城建股份，自本次划转完成股权登记之日起十二个月内不向合肥兴泰金融控股（集团）有限公司控制的其他企业之外的主体转让。”

(2)2020年1月，合肥城建向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产事项完成标的资产过户手续，本次交易中，合肥城建控股股东兴泰集团出具股份锁定承诺如下：

“1、本公司在本次重组实施完毕前持有的合肥城建股份，自本次重组实施完毕之日起12个月内不向合肥兴泰金融控股（集团）有限公司控制的其他企业之外的主体转让；2、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同；3、如前述股份的锁定期安排与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。”

截至本公告披露之日，上述承诺均已履行完毕。

四、相关风险提示

1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

2、控股股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照规定及时披露减持计划的实施进展情况。

3、在本次计划减持期间，控股股东将严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

五、备查文件

1、控股股东签署的《关于减持股份的告知函》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十日

证券代码：688368　证券简称：晶丰明源　公告编号：2026-085

上海晶丰明源半导体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,245,368股。本次股票上市流通总数为3,245,368股。

● 本次股票上市流通日期为2026年9月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282号），同意上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的注册申请。

公司向本次交易对方中的41名交易对方发行人民币普通股（A股）40,352,386股，并于2026年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次新增股份登记。具体情况详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-019）。

根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，上述新增发行股份涉及差异化股份锁定安排，其中，本次上市流通的5名限售股股东因本次交易取得的公司股份自该等新增股份发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，上述限售股股东持有公司股份数量合计3,245,368股，占公司当前总股本的1.59%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2026年4月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次交易募集配套资金向特定对象发行股票的新增股份登记手续，本次发行股票数量为16,861,826股，发行对象18名，限售期均为6个月，自股份发行完成之日起开始计算，限售股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司总股本由128,852,867股增加至145,714,693股，其中，有限售条件股份数量由40,352,386股增加至57,214,212股，占公司总股本的比例由31.32%变更为39.26%。

2026年6月9日，公司2025年年度权益分派实施完成，以实施权益分派股权登记日登记的总股本145,714,693股扣减回购专用证券账户持有的913,580股后，实际参与本次权益分派的股本数144,801,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）、以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股，即合计派发现金红利144,801,113元（含税），合计转增57,920,445股，转增后公司总股本由145,714,693股增加至203,635,138股，其中，有限售条件股份数量由57,214,212股增加至80,099,897股，占公司总股本的比例由39.26%变更为39.34%。

2026年7月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为171,754股，登记完成后，公司总股本由203,635,138股增加至203,806,892股，其中，有限售条件股份数量未发生变化，占公司总股本的比例由39.34%变更为39.30%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，相关发行对象承诺因本次交易取得的公司股票，自该等新增股份发行结束之日起6个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为3,245,368股

（二）本次上市流通日期为2026年9月18日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	2,020,862	0.99%	2,020,862	0
2	新余新鼎啸哥威给陆号投资管理合伙企业（有限合伙）	443,821	0.22%	443,821	0
3	新余新鼎啸哥拾玖号投资管理合伙企业（有限合伙）	201,468	0.10%	201,468	0
4	青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙）	411,328	0.20%	411,328	0
5	平潭寰鑫股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	167,889	0.08%	167,889	0
合计		3,245,368	1.59%	3,245,368	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	3,245,368	自发行结束之日起6个月
合计	/	3,245,368	/

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：688233　证券简称：神工股份　公告编号：2026-051

锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第三届董事会第十四次会议、于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了公司关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

2026年9月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，并调整本次发行的拟募集资金规模。公司本次发行方案的具体调整内容如下：

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	–	更新了“修订的董事会决议”、“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”
2	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”
3		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了“最新的第一大股东股份数及其持股比例”
4		八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了“修订的董事会决议”
5	第二节 董事会关于本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”
6		二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了“三个募投项目的募集资金投资净额及项目审批进度”
7	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了“截至2026年6月30日的财务数据”
8		六、本次股票发行相关风险说明	更新了“截至2026年6月30日的财务数据”
9	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响、填补的具体措施及相关的主体承诺	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”、“2026年截至6月30日，研发人员人数及占比、专利数量”

本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：688233　证券简称：神工股份　公告编号：2026-049

锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年9月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，现对公司2026年度向特定对象发行A股股票方案中募集资金规模进行调整。具体如下：

原内容：

募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	硅零部件扩产项目	57,747.25	50,000.00
2	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目	30,138.46	30,000.00
3	研发中心建设项目	20,643.13	20,000.00
合计		108,528.84	100,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整为：

募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过81,028.32万元（含81,028.32万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入扣除发行费用后的募集资金净额
1	硅零部件扩产项目	57,747.25	41,369.28
2	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目	30,138.46	23,659.04
3	研发中心建设项目	20,643.13	16,000.00
合计		108,528.84	81,028.32

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《锦州神工半导体股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：688233　证券简称：神工股份　公告编号：2026-053

锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2026年9月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过81,028.32万元（含本数），本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下：

（一）财务指标计算的主要假设和前提

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境及产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行方案于2026年11月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设发行数量为17,030,574股（以预案出具日公司总股本170,305,736股的10%测算），募集资金总额为81,028.32万元，本测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润等之外的其他因素对净资产的影响；

5、公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为10,203.71万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10,032.24万元；

6、假设公司2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按以下三种假设进行测算：1）较2025年减少10%；2）与2025年持平；3）较2025年增加10%。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

7、假设2026年除本次发行外，不存在其他导致公司总股本变化的因素；

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年盈利情况的承诺，也不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下：

项目	2025年度/2025.12.31	2026年度/2026.12.31	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	17,030.57	17,030.57	18,733.63
本次发行股份数量（万股）	1,703.06		
假设情形一：2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年减少10%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,203.71	9,183.34	9,183.34
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,032.24	9,029.02	9,029.02
基本每股收益（元/股）	0.60	0.54	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.54	0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.59	0.53	0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.59	0.53	0.53
假设情形二：2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2025年持平			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,203.71	10,203.71	10,203.71
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,032.24	10,032.24	10,032.24
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.58
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.58
假设情形三：2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年增加10%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,203.71	11,224.08	11,224.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,032.24	11,035.47	11,035.47
基本每股收益（元/股）	0.60	0.66	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.66	0.65
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.59	0.65	0.64
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.59	0.65	0.64

注：每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目存在一定的实施周期，可能在短期内难以实现预期效益，从而存在本次发行完成后每股收益被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力，具有充分的必要性和可行性。

关于本次向特定对象发行募集资金投资项目的必要性和合理性具体分析，详见《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于主营业务相关项目建设，募集资金投资项目属于围绕现有业务的固有产品及新产品研发、技术升级与产业化项目，有望进一步丰富公司产品矩阵，提高公司核心竞争力，增强可持续盈利能力，促进公司高质量转型发展。

公司为国内领先的硅材料、硅零部件生产企业之一，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司以“科技创新、技术报国”为宗旨，以“专注技术、强调质量、服务客户”为经营理念，致力于成为有市场地位、有技术优势和研发实力、有高性价比产品、有良好品质管理及售后服务的优秀半导体材料和半导体零部件供应商。公司将继续着眼于国际半导体行业，引进有着丰富生产、管理经验的复合型专家；同时吸纳国内有一定基础的中端技术人员；巩固并加强中国本土技术人才梯队，提升公司的人才竞争优势。截至2026年6月末，公司研发人员85人，占员工总数量的20.68%，主要研发人员均有丰富的行业工作经验。

技术储备方面，公司聚焦“硅零部件精密加工”、“半导体碳化硅涂层技术”两大核心方向，同步强化工艺智能化管控领域布局，深耕半导体级单晶硅材料及应用产品赛道，研发成果丰硕，专利申请与授权工作稳步推进，进一步夯实了公司“材料+零部件”一体化核心竞争优势，为业务高质量发展提供有力技术支撑。公司在硅零部件上的技术储备十分丰富，已有20余项核心技术。截至2026年6月30日，公司拥有111项专利，其中22项为发明专利，89项为实用新型专利。公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业等多项证书，充分证明公司的技术储备及研发实力。

市场储备方面，公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位，已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链。公司已扎根于分工严密的国际半导体供应链中，将硅材料直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商，例如美国泛林集团（Lam Research）和日本东电电子（Tokyo Electron Limited,TEL），并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商，下游产业链丰富且实力雄厚。同时公司已取得本土硅零部件市场的领先地位，已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链，以高端品类为主，发挥了独特的国产化作用，市场空间潜力大。

综上所述，公司拥有充足的人员、技术和市场储备，为顺利推进募集资金投资项目提供了充分保障。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次发行募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，公司拟采取一系列措施以提升公司经营业绩，为股东持续创造回报，具体如下：

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范、有效使用

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。本次募集资金到位后将存放于公司董事会决议开设的专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定，在进行募集资金投资项目时，严格履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并及时履行相关信息披露义务。

（二）积极、稳妥地实施募集资金投资项目，实现项目预期回报

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略，可有效提升公司业务实力、技术水平，从而进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作，对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，争取早日投产并实现预期效益。

（三）不断完善公司治理，进一步提高经营管理能力

公司已建立健全了内部管理体系，能够保证公司各项经营活动得到有序开展。公司未来将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高经营管理能力，完善决策程序、优化管理流程、强化执行监督，促进公司规范运作，全面提升公司的经营效率和效果，保护公司和投资者的合法权益。

（四）持续完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核

公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用于非经营性活动，提高资金使用效率；严格控制费用支出，加大成本控制力度，降低运营成本，提升公司利润率；加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，保障公司持续、稳定、健康发展。

（五）完善利润分配政策，优化投资者回报机制

公司制定了详细的利润分配原则、利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制；在具备现金分红的条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。此外，公司还制定了《锦州神工半导体股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，进一步明确了未来三年（2026-2028年）的利润分配政策，积极落实对股东的利润分配，促进对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保障投资者的权益。

（六）其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

此外，公司提示广大投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

六、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

1、在任何情况下，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来实施股权激励计划，股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后，如中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定的，本人届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：688233　证券简称：神工股份　公告编号：2026-052

锦州神工半导体股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第三届董事会第十四次会议、于2026年5月29日召开2026年第二次